

PCB线路板导热液体灌封硅胶 铝基板散热型密封硅橡胶

产品名称	PCB线路板导热液体灌封硅胶 铝基板散热型密封硅橡胶
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	65.00/件
规格参数	品牌:硅诚硅胶 用途:导热阻燃三防 阻燃级别:94V0
公司地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房
联系电话	13714093962

产品详情

PCB线路板耐高温液体灌封硅胶 导热系数高的灌封胶：

本产品为高分子有机硅像材料，采用聚合物反应技术，具备较高的导热散热性能，矩形密闭结构，防水绝缘耐老化效果突出；双组份液体硅胶材料，可自动填充产品结构缝隙进行深度硫化，成型后的导热灌封硅胶柔韧性好，防水防潮等级可达IPX7级，可将发热能力进行有效传导、散发，一般保护产品年限在5-10年，广泛应用于高功率线路板、高功率电源模组、新能源PACK电池等产品的灌封保护。

PCB线路板耐高温液体灌封硅胶性能特点：

- 1.柔韧性材料，有较好的抗震动冲击及变形能力；
- 2.胶体粘度值低，流动性好，可快速自流平；
- 3.防水防潮绝缘导热、耐候性好，可长久保护产品；
- 4.铂金催化环保材料，对线路板原件无腐蚀性；
- 5.高绝缘，灌封后的产品工作稳定；
- 6、具有可拆性，灌封硫化后的电子元器件可取出进行修理和更换，再次用本产品灌封，不留痕迹。

导热电子灌封硅胶的参数：

产品特性	单位	数值	产品特性	单位	数值
诱点率	KHz	3.75	介电常数	KHz	3.8 ~ 4.2
线收缩率	%	0.3	硬度	邵氏A	30 ± 2
耐水性	d	3	耐湿		90-110
耐油性	体积电阻	25	ohm-cm	1.35 × 10 ¹⁵	
耐湿热性	h	120	表面电阻	25 ohm	1.2 × 10 ¹⁴
耐冻融循环	次	15	耐电压	25 kv/mm	16 ~ 18
混合粘度	cps	< 4500	阻燃级别	/	94V0
操作时间	Min	20-30	初步硫化时间	h	1.5-2
与金属、镀锌基材、PVC、PCB具备良好的附着力（环保无腐蚀）					
<p>以上性能数据均在25℃，相对湿度55%固化1天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。</p>					

线路板导热液体灌封硅胶使用方法：

- 1、清理线路板：用无水酒精和硬毛刷刷洗清理线路板表层，需注意焊接点的松香残留、焊锡渣等残留物，等待干燥，涂覆防水胶等待固化；
- 2、将AB胶料按照重量比，混合搅拌均匀，灌胶于施工区域面，灌胶时，尽量沿着边缘部位缓慢倾注，等待充分填充整个线路板；
- 3、等待灌封硅胶材料硫化，硫化时间受环境温度影响，25℃硫化时间为3-4小时（操作时间与硫化时间都可根据产品工艺进行调整）；
- 4、完成之后，根据实际情况抽测或全测线路板功能是否正常。

产品注意事项：

- 1、需将灌封的产品保持干燥，清洁，周围环境良好，以便于灌封；
- 2、灌封前，建议先检查A胶，看是否有沉淀物产生，如有，将A胶充分搅拌均匀即可；
- 3、严格按照混合比例称重配比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，让A\B胶能够充分交联反应，以免出现固化不完全的情况，造成材料的浪费；
- 4、搅拌均匀后视情况是否需要做排泡处理，需及时将混合好的胶料进行灌封，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液（使用前可计算好硅胶的用量）；
- 5、灌注后，胶液会逐渐渗透到产品的缝隙中，必要时请进行二次灌胶；
- 6、固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。

售后服务：

我司承若，如因硅胶质量问题，三个月内无条件退换货；可以免费提供教学视频，在使用硅胶过程中，如有任何技术问题，都可以与我们随时联系，免费提供技术支持，新产品的研发。

PCB线路板耐高温液体灌封硅胶 导热系数高的灌封胶